

MEMS実装・パッケージングフォーラム

主催：マイクロマシンセンター/MEMS協議会 共催：溶接学会 マイクロ接合委員会

開催日時：2009年7月29日(水) 13:00~15:50

開催場所：マイクロマシン/MEMS展会場内 マイクロナノ2009特設会場B

【プログラム】

13:00~13:10	開催の挨拶	マイクロマシンセンター 専務理事 青柳桂一
13:10~13:50	MEMSの集積・融合の進展と 新産業創出への期待	立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構 教授 杉山進
13:50~14:30	電子デバイス実装の展開と今後の動向	大阪大学大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授 藤本公三
14:30~14:50	ウェハレベルパッケージングによる 機能集積MEMSの創出	パナソニック電工 微細プロセス開発センター センター長 久保雅男
14:50~15:10	異種材料多層MEMS集積化技術開発	オリンパス 研究開発センター精密技術開発本部 MEMS開発部 部長 太田亮
15:10~15:30	In-Line WLP(Wafer Level Package)技術を用いた 低コストRF-MEMSバリアブル キャパシタの開発	東芝 生産技術センター 実装技術研究センター 小幡進
15:30~15:50	非線形リソグラフィを用いた 立体基板上へのパターンニング技術	大阪大学大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 助教 西山宏昭

敬称略。都合により多少の変更がある場合もございます。(6月8日現在)